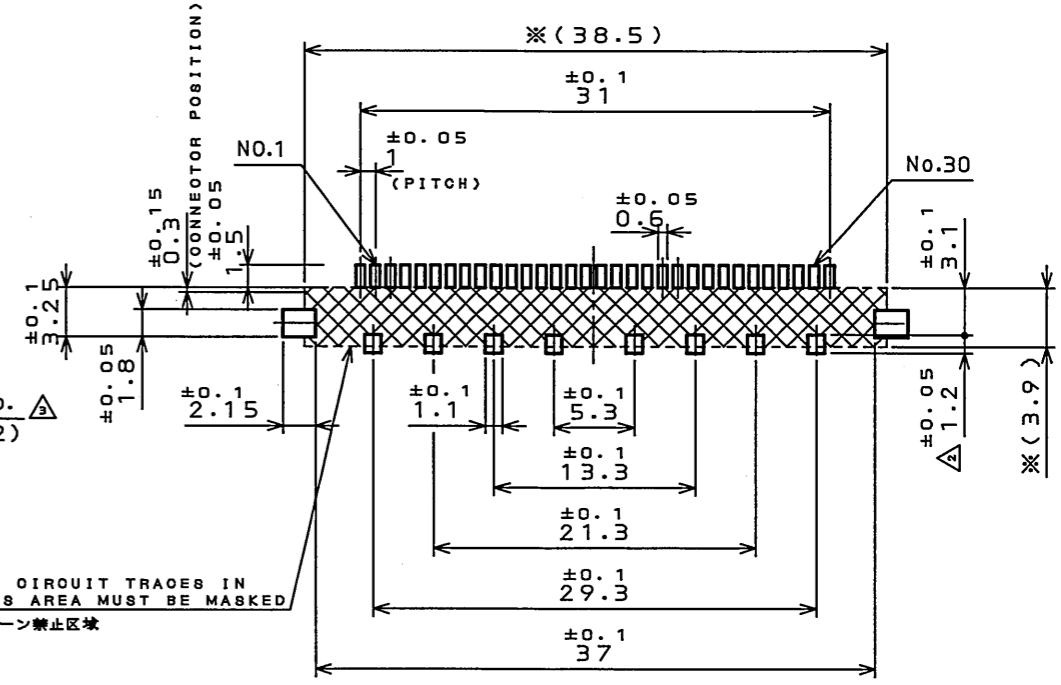
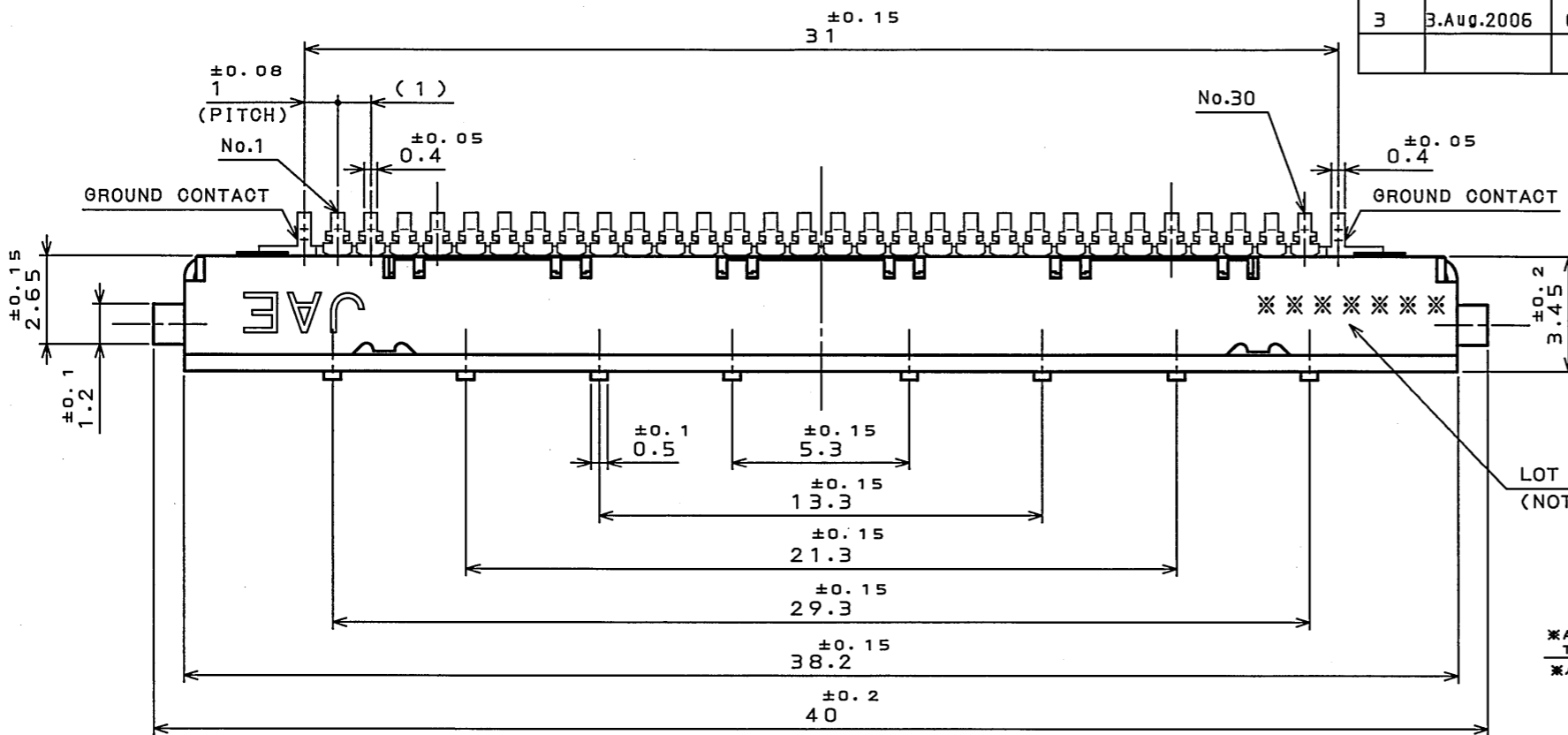


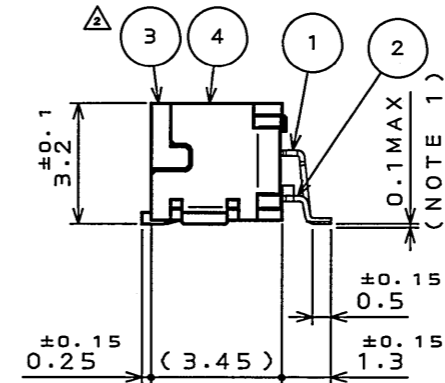
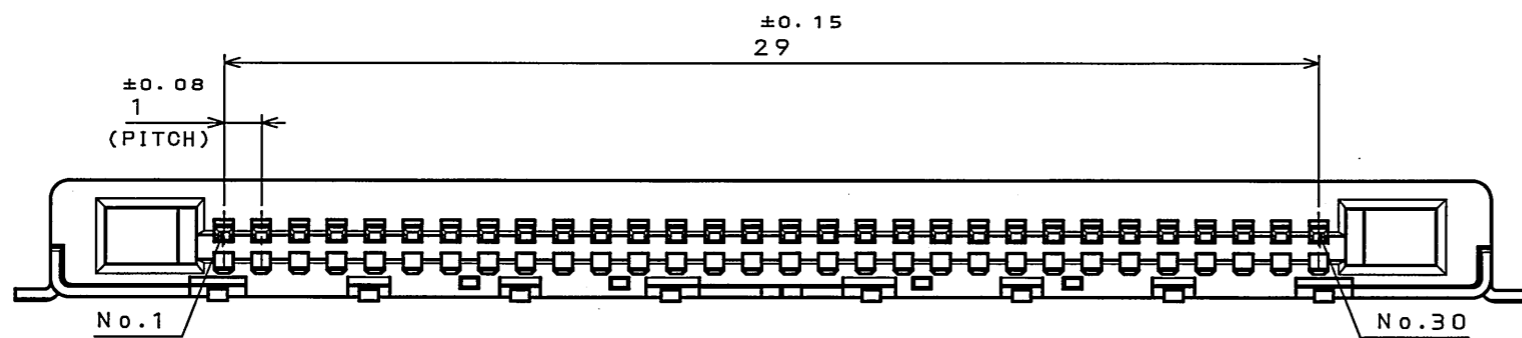
0ZZ8E0rs
(ON DRAWING) 台要図

版数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
2	18.Mar.2004	054650	ADDED DIMENSIN etc 寸法追加、他		K.HISAMATSU	M.SUZUKI	Y.ICHIIYAMA
3	3.Aug.2006	060641	ADDED LOT No. AND NOTE. ロットNo.と注記追加	M.ABE	K.HISAMATSU	M. Suzuki	K. Hisatome



*ANY CIRCUIT TRACES IN THIS AREA MUST BE MASKED
*パターン禁止区域

APPLICABLE P.C.B. DIMENSION (REF.)
適合基板寸法(参考)



符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS
4	SHELL シェル	1	STAINLESS STEEL ステンレス	TIN PLATING スズメッキ	
3	INSULATOR インシュレータ	1	HEAT RESISTING PLASTIC 耐熱性プラスチック		UL94 V-0
2	GROUND PLATE クランドプレート	1	COPPER ALLOY 銅合金	TIN PLATING スズメッキ	
1	CONTACT コンタクト	30	COPPER ALLOY 銅合金	TABLE 1	

仕様書 (SPECIFICATION)		第1版 (ORIGINAL DATE)		尺度 (SCALE)		シリーズ (SERIES)		備考 (REMARKS)	
JACS-1752-*		2.Sep.2003		5:1		FI-E		日本航空電子工業株式会社	
公差 (GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.		名称 (TITLE)		F I - E 3 0 S		JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.	
寸法 (DIMENSION)		担当 CHK.		査閲 APPD.		質量 (MASS)		図面番号 (DRAWING NO.)	
. ±0.8		M.TAKAKU		承認 APPD.		◎		SJ038770	
.X ±0.4		Y.ICHIIYAMA						版数 (REV.)	
.XX ±0.1								3	
.XXX ±									

TABLE 1

CONTACT AREA 接触部	SOLDERING AREA 端子部
GOLD OVER NICKEL Ni上Au	TIN-COPPER OVER NICKEL Ni上SnCu

NOTE1. COPLANARITY BETWEEN TERMINAL AND HOLD DOWN OF SHELL SHOULD BE 0.1mm MAX.
△ 2. PRODUCTION LOT NUMBER AS INDICATED.
注1. 端子及び、シェルのホルルドダウンの相互のバラツキは0.1以内とする。
△ 2. 図示の位置にロット番号を表示する。

LEAD FREE この製品は鉛フリー品です

JAE CONNECTOR DIV. PROPRIETARY.
COPYRIGHT(C) 2003, JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.

DOF-0-212F(05.08)

